

CIS 芯片测试设备



- ☆多 site 并行测试，最多 16 个；
- 支持标准 Tray 盘直接传送或移载产品；
- 兼容 Jdect tray 及 2, 3, 4tray；
- 有效解决芯片在 TRAY 和 SOCKET 内的容差不一问题，芯片移载过程的定位精度和可靠性有保证；
- 可选配视觉定位机构；
- 浮动头可有效率平衡测试压力
- ☆具备 IC 残留检测功能
- 具备 IC 平整度检测功能
- 与测试机间使用 TCP/IP 协议，灵活可靠，扩展性强；
- 模块化设计，适用 CIS 芯片测试；